

(43) 国際公開日
2007 年 1 月 18 日 (18.01.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/007731 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
B08B 6/00 (2006.01) H02N 13/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/313721
- (22) 国際出願日: 2006 年 7 月 11 日 (11.07.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-231315 2005 年 7 月 12 日 (12.07.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社クリエイティブテクノロジー (CREATIVE TECHNOLOGY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1020083 東京都千代田区麹町 1-8-1 4 麹町 YK ビル 5 F Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 原野 理一郎 (HARANO, Riichiro) [JP/JP]; 〒1020083 東京都千代田

区麹町 1-8-1 4 麹町 YK ビル 5 F 株式会社クリエイティブテクノロジー内 Tokyo (JP). 辰己 良昭 (TATSUMI, Yoshiaki) [JP/JP]; 〒1020083 東京都千代田区麹町 1-8-1 4 麹町 YK ビル 5 F 株式会社クリエイティブテクノロジー内 Tokyo (JP). 宮下 欣也 (MIYASHITA, Kinya) [JP/JP]; 〒1020083 東京都千代田区麹町 1-8-1 4 麹町 YK ビル 5 F 株式会社クリエイティブテクノロジー内 Tokyo (JP). 藤澤 博 (FUJISAWA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒6308301 奈良県奈良市高畑町 5 3 7-7 Nara (JP).

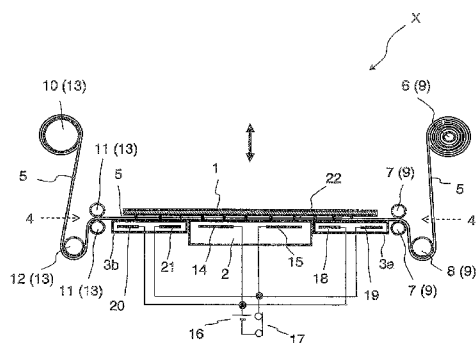
(74) 代理人: 成瀬 勝夫, 外 (NARUSE, Katsuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 2 丁目 1 1 番 5 号 T K K 西新橋ビル 5 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ,

[続葉有]

(54) Title: APPARATUS FOR REMOVING FOREIGN MATERIAL FROM SUBSTRATE AND METHOD FOR REMOVING FOREIGN MATERIAL FROM SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 基板の異物除去装置及び基板の異物除去方法



(57) Abstract: An apparatus and a method for removing foreign materials from a substrate which eliminate a possibility of readhesion of the foreign materials adhered on the substrate by surely removing the foreign materials and are applicable even to large substrates. The foreign material removing apparatus is provided with electrostatic chucks (2, 3) which form a substrate attracting plane (4) for attracting the substrate (1); a resin sheet supplying means (9) for supplying the substrate attracting plane (4) with a resin sheet (5); a resin sheet recovering means (13) for recovering the supplied resin sheet (5), and a substrate transfer means for transferring the substrate (1). The substrate (1) supplied to the electrostatic chucks (2, 3) by the substrate transfer means is permitted to be attracted to the substrate attracting plane (4) through the resin sheet (5), and the foreign materials (22) adhered on a side of the substrate attracting plane (4) of the substrate (1) are transferred onto the resin sheet (5) and removed.

(57) 要約:

基板に付着した異物を確実に除去して再付着のおそれを排除し、かつ、大型の基板でも適用可能な基板の異物除去装置、及び異物除去方法を提供する。基板 (1) を吸着させる基板吸着面 (4) を形成する静電チャック (2, 3) と、基板吸着面 (4) に樹脂シート (5) を供給する樹脂シート供給手段 (9) と、供給した樹脂シート (5) を回収する樹脂シート回収手段 (13) と、基板 (1) の搬送を行う基板搬送手段とを備えた異物除去装置であり、基板搬送手段によって静電チャック (2, 3) に供給された基板 (1) を樹脂シート (5) を介して基板吸着面 (4) に吸着させ、該基板 (1) の基板吸着面 (4) 側に付着した異物 (22) を樹脂シート (5) に転移させて取り除く。



LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。